

## 广州方邦电子股份有限公司

### 2022 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

#### 一、2022 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	
营业总收入	31,262.63	28,619.05	29,246.99	6.89
营业利润	-6,533.91	4,606.08	4,408.13	-248.22
利润总额	-6,531.03	4,616.20	4,418.24	-247.82
归属于母公司所有者的净利润	-6,801.80	3,507.00	3,309.05	-305.55
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-8,208.75	1,682.93	1,484.98	-652.79
基本每股收益（元）	-0.85	0.44	0.41	-307.19
加权平均净资产收益率	-4.31	2.17	2.05	-310.10
	本报告期末	本报告期初（调整前）	本报告期初（调整后）	增减变动幅度（%）
总资产	196,793.09	192,685.27	192,487.31	2.24
归属于母公司的所有者权益	154,414.09	162,242.14	162,044.18	-4.71
股本	8,021.05	8,000.00	8,000.00	0.26

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	19.25	20.28	20.26	-4.98

注：1.追溯调整或者重述的原因说明：公司为执行《企业会计准则解释第15号》：企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，根据相关规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2022年度报告为准。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

报告期内，公司实现营业总收入31,262.63万元，同比增长6.89%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,801.80万元，同比下降305.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,208.75万元，同比下降652.79%。

报告期末，公司总资产196,793.09万元，较报告期初增长2.24%；归属于母公司的所有者权益154,414.09万元，较报告期初下降4.71%；归属于母公司所有者的每股净资产19.25元，较报告期初下降4.98%。

#### 影响经营业绩的主要因素：

1、报告期内，全球疫情起伏反复、经济增长承压、居民部门消费动力不足，全球智能手机终端销售呈现疲软局面，公司主要产品屏蔽膜销量同比出现了约20%的下降，销售收入同比下降约22.43%。

2、本年度实现铜箔产品销售收入12,289.43万元，同比增长154.57%，但因

铜箔业务产品主要为锂电铜箔、标准电子铜箔，为过渡性产品，且铜箔客户类型主要为贸易商客户，销售价格低于市场平均水平，铜箔的产能利用率、良率仍低于行业平均水平，同时，二季度和三季度受疫情、产品结构调整等影响销量出现明显下降，全年实现铜箔产品销量约 1600 多吨，未能形成规模效应，叠加相应折旧费用，铜箔生产成本高于行业平均水平，导致铜箔业务出现较大亏损。

3、报告期内母公司总部及生产基地投产，相应折旧摊销等费用同比大幅增加。

4、报告期内，为满足公司未来业务拓展需要，公司持续加大研发投入，由于公司研发产品为基础复合电子材料，应用领域涉及芯片封装、超细线路 FPC 制备以及新能源电池新一代负极集流体等，认证周期长、且生产稳定以及提升良率需要时间，年度内如可剥离铜箔等新产品暂未产生销售。

5、非经常性损益影响：本年度公司非经常性损益金额较上年同期减少。

## （二）主要财务数据和指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润等指标同比增减变动幅度较大，主要原因是：铜箔业务受成本、售价及产品结构等影响导致经营利润产生较大亏损，屏蔽膜业务受智能终端出货量下降等影响导致经营利润同比下降。

## 三、公司相关新产品进展情况

截至本公告披露日，公司相关新产品进展情况公告如下：

带载体可剥离超薄铜箔（以下简称“可剥铜”）主要应用于 IC 载板，目前正在进行客户认证，送样品质稳定，某宽幅产品已通过部分载板厂商的物性、工艺测试，并通过了部分终端的首轮验证。

挠性覆铜板（FCCL）是制备柔性电路板（FPC）的基材，目前正在进行小批

量量产工作，常规 FCCL 已在 2022 年三、四季度落实小额订单。极薄 FCCL 目前仍处于客户测试认证阶段。

电阻薄膜产品主要应用于智能手机声学部件，目前处于客户认证阶段，部分产品已通过相关客户的基本物性及工艺测试、批量稳定性测试，终端认证正在进行。

PET 铜箔主要应用于新能源电池负极集流体。目前，公司 PET 铜箔已向部分下游客户进行了送样。

#### 四、风险提示

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准。

可剥铜、挠性覆铜板以及电阻薄膜属于基础电子专用材料，认证周期长、认证程序严格，叠加目前消费电子市场需求不景气，整个认证周期、订单落实时间及订单量大小具有不确定性。PET 铜箔为新能源电池新一代负极集流体材料，其认证进度及订单落实很大程度取决于下游客户对 PET 铜箔的认可、应用意愿和进度，具有不确定性。

敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日